

概 要

本概要旨在為閣下提供本文件所載資料的概覽。本節內容僅為概要，並未載列可能對閣下而言屬重要的所有資料。閣下決定[編纂][編纂]前，務請閱讀本文件全文。任何[編纂]均存在風險。[編纂][編纂]的若干具體風險載於本文件「風險因素」一節。閣下決定[編纂][編纂]前，務請細閱該節。

概覽

我們是光電互連產品提供商，提供光模塊、有源光纜（「AOC」）（其將光模塊及光纖纜線集成為單一組件以實現高速互連）及其他產品。我們的光電互連產品廣泛應用於AI數據中心，以支持高速、高密度及高能效的數據傳輸。我們建立從芯片設計到光模塊製造的端到端技術能力，並專注於硅光子（「硅光子」）技術領域。

我們的光模塊產品組合涵蓋100G、200G、400G及800G傳輸速率，兼容多種行業標準外型規格。所有400G及以上規格的單模光模塊均採用硅光子技術。我們的AOC及其他產品線可滿足客戶多樣化需求，在產品組合中產生協同效應並創造交叉銷售機會。

根據弗若斯特沙利文的資料，按收入計，我們於2025年在全球光模塊供應商中排名第十七，2025年的全球市場份額為0.8%（按收入計）。根據同一來源，按2025年AI光模塊收入計，我們在中國光模塊供應商中排名全球第八，全球市場份額為1.6%。

我們的產品

我們設計、製造並銷售光電互連產品，包括(i)光模塊；(ii)AOC；及(iii)其他。截至最後實際可行日期，我們的絕大多數光電互連產品用於AI數據中心。

光模塊

我們按其基於硅光子技術還是非硅光子技術（即硅光子光模塊及其他光模塊）將光模塊分類。於往績記錄期間，我們來自硅光子光模塊的收入增長強勁。

硅光子光模塊

我們的硅光子光模塊是基於硅光子技術開發的光模塊，旨在將硅光子芯片應用於單模光模塊。截至最後實際可行日期，我們主要的硅光子光模塊傳輸速率均為400G及以上。該等產品廣泛部署於互聯網企業的AI數據中心，為大規模模型訓練、雲工作負載及骨幹網互聯提供支持。我們致力於持續升級硅光子光模塊。

截至最後實際可行日期，我們擁有四款已商業化的硅光子光模塊及一款正在開發中的已商業化硅光子光模塊。

概 要

其他光模塊

我們的其他光模塊主要包括100G、200G、400G及800G多模式光模塊。該等產品憑藉廣泛的兼容性、先進的技術及較高的成本效益，已在多種應用場景(尤其是數據中心)中得到廣泛部署。

AOC

AOC為光電互連產品，其將光模塊與光纖整合至單一纜線組件中，可在短距離內實現高速、低延遲的數據傳輸，且耗電量更低。AOC用於機櫃內或相鄰設備間的短距互連需求，可作為光模塊的補充，而光模塊通常用於服務器與交換機之間較長距離的數據傳輸。

我們根據AOC是否基於硅光子技術或非硅光子技術(即硅光子AOC及其他AOC)進行分類。

硅光子AOC

截至最後實際可行日期，我們的硅光子AOC正在開發中。憑藉我們的專有技術，我們正在開發硅光子AOC，例如400G硅光子AOC、800G硅光子AOC及PCIe 6.0 AOC，以滿足市場對高帶寬、更低功耗及更強整合性不斷增長的需求。

其他AOC

我們的其他AOC產品已商業化且處於量產階段。我們的其他AOC產品廣泛應用於數據中心及其他高速傳輸場景。

AEC

AEC為高速電氣互連產品，其於銅纜兩端整合具備主動均衡與放大功能的芯片，以提升信號完整性並延伸傳輸距離。在數據中心互連應用中，AEC是AOC及光模塊的補充。AOC採用光纖實現低損耗光傳輸，適用於中短距離連接；而AEC在銅質導體上實現相當的傳輸性能，特別適用於服務器內部或相鄰設備間的超短距離連接。

我們已於2025年12月起開始將我們的AEC產品商業化。

我們的業務模式

我們主要透過三種模式開展業務，包括(i)聯合設計製造(「JDM」)模式；(ii)原始設計製造商(「ODM」)模式；及(iii)自有品牌模式，以滿足客戶的多元化需求。

我們的JDM模式

隨著全球領先互聯網企業及雲服務提供商對定製化光模塊的需求日益增長，傳統標準化產品及分散的供應鏈已無法充分滿足市場對性能及可靠性的嚴苛要求。

概 要

憑藉與客戶建立的長期信賴及合作，我們能夠深入了解其技術路線圖及產品需求，使我們能夠共同開發迎合其特定需求的下一代光電互連產品。為此，我們採用了JDM模式，且自2022年起，根據JDM模式與我們的主要客戶開展合作。

於JDM模式下，我們的客戶授權我們使用其專有設計、技術規格及相關專利技術，以進行產品定製及共同開發，而我們則利用先進的研發及製造能力，交付可滿足其嚴格要求的高性能、可靠及可擴展的光模塊產品。

我們的ODM模式

在ODM模式下，我們根據客戶的規格和要求設計和製造產品，而最終產品則以客戶自有品牌進行營銷和銷售。這種模式使我們能夠利用我們的設計和研發能力，同時受益於客戶已建立的品牌認知度和分銷網絡。

例如，自2022年以來，我們與一家全球領先的互連解決方案提供商合作，其於往績記錄期間同時是我們的前五大客戶和前五大供應商之一。通過此次合作，我們的產品以客戶的品牌銷往海外市場，有利於我們進入新的地理市場和客戶群體。

我們的自有品牌模式

在我們的自有品牌（「PL」）模式下，我們直接向客戶供應標準化的光模塊和光電互連產品，並以我們自己的品牌銷售。這種模式使我們能夠接觸更廣泛的客戶群體並有效地滲透市場。

研發

於2023年、2024年及2025年，我們的研發開支分別為人民幣42.3百萬元、人民幣63.8百萬元及人民幣104.3百萬元，分別佔我們總收入的24.1%、7.4%及8.5%。儘管於往績記錄期間，我們研發開支的絕對金額有所增加，但我們的研發開支佔同期收入的百分比整體呈下降趨勢，主要因為我們產生的收入增長遠超研發開支的增長，這體現了研發成果商業化程度提高所帶來的研發效率提升。截至2025年12月31日，我們的研發團隊擁有211名成員，佔員工總數的約45.1%。超過31.8%的研發成員平均擁有十年的全球行業經驗，包括在知名跨國企業的從業背景。有關進一步詳情，請參閱「業務—研發」。

概 要

我們的技術

產品研究及開發中的主要技術

我們在產品研究及開發中採用的關鍵技術包括但不限於以下各項：

- **硅光子芯片設計**。我們開發並維護用於硅光子技術的器件庫。透過結合多物理場模擬（涵蓋電磁、熱與光電效應）與實際晶圓測試數據，我們為設計準確性與製造穩健性持續優化器件模型。憑藉器件庫，我們實現從架構定義到佈局驗證的硅光子芯片設計，並與晶圓廠協作，透過閉環反饋與製程優化達成高良率晶圓製造與穩定量產。
- **光學與電氣設計**。我們整合光學與電氣設計能力，以提升耦合效率、信號完整性及整體傳輸性能。我們的專有設計庫及仿真模型支持快速迭代及高精度優化。
- **機械與結構設計**。我們專注於小型化、熱管理及模塊化集成。我們的標準化組件庫及機械設計工具實現了可擴展的生產及產品性能的一致性。
- **固件與自動化**。我們開發嵌入式固件，確保多協議互操作性、實時監控以及對光電轉換、溫度及功率管理的智能控制。
- **先進製造與自動化**。我們已建立自動化晶圓測試及封裝系統以及AI賦能的生產線，以確保在整個製造過程中的高良率、質量一致性及可追溯性。我們的WIMO集成在數字化製造環境下實現了從硅晶圓輸入到光模塊輸出的無縫流程。
- **製造工藝實驗室**。在設計驗證階段，我們針對製造工藝執行全面評估，包括工藝黏合強度評估、傅里葉變換紅外光譜測試、黏度測試、差示掃描量熱測試以及晶粒剪切測試。這些評估確保關鍵材料與工藝參數在量產前具備可靠性及穩定性。
- **可靠性實驗室**。在投入量產之前，我們會進行全面的可靠性測試，包括高溫工作壽命（「HTOL」）、溫度循環、偏壓濕熱、電磁干擾及靜電放電測試，以及其他機械可靠性評估。此外，我們已針對光電芯片與硅光子芯片建立專屬可靠性測試平台，包含芯片級HTOL及大光輸入耐久性測試。
- **系統兼容性測試平台**。在開發中產品完成設計驗證後，我們會進行全面的系統兼容性測試，以驗證產品在不同網絡環境下的性能表現。產品通過各品牌的網絡接口卡、交換器及其他專用網絡設備進行測試，確保硬件性能與固件功能在多元化的客戶網絡場景中均能實現全面兼容。

概 要

我們的優勢

我們相信下列優勢將使我們處於能夠把握未來機遇及實現持續增長的有利地位：

- (i) 創始人與團隊：具有深厚光電互連行業專業知識的創始人及經驗豐富且具多元化專業優勢的團隊；
- (ii) 聚焦AI：我們提供支持AI計算的高速度、低功耗、低延遲光電互連產品；
- (iii) 聚焦硅光子：經驗豐富的研發團隊致力於推動下一代AI光電集成發展；及
- (iv) 業務模式：構建從上游硅光子晶圓廠至下游領先雲服務提供商的完整產業鏈。

我們的策略

我們擬實施下列策略：

- (i) 技術：持續推進硅光子技術與光電集成；
- (ii) 產能建設：擴充硅光子及光電共封裝產能以滿足快速增長的下游需求；
- (iii) 國內客戶：把握中國AI轉型機遇，驅動銷售持續增長；及
- (iv) 海外客戶：深化與重點合作伙伴的合作。

我們的客戶及供應商

於往績記錄期間，我們的客戶主要包括全球領先的互聯網公司及中國互聯網公司。於2023年、2024年及2025年，我們五大客戶產生的收入分別為人民幣168.0百萬元、人民幣605.9百萬元及人民幣961.0百萬元，分別佔我們總收入的95.8%、70.3%及78.7%。此外，於2023年、2024年及2025年，我們最大客戶產生的收入分別佔我們總收入的48.3%、25.2%及21.0%。更多詳情請參閱「業務—我們的客戶」。

於往績記錄期間，我們的供應商主要包括全球及國內電子組件、光電零件、印刷電路板及半導體器件提供商。於2023年、2024年及2025年，我們向五大供應商的採購金額分別為人民幣157.3百萬元、人民幣683.3百萬元及人民幣864.3百萬元，分別佔我們採購總額的62.6%、72.5%及56.6%。此外，於2023年、2024年及2025年，向我們最大供應商的採購額分別佔我們採購總額的24.9%、29.8%及28.4%。更多詳情請參閱「業務—採購及供應鏈管理—供應商選擇及管理—我們的主要供應商」。

概 要

市場機遇

為應對AI數據中心與硅光子技術帶來的不斷增多的市場機遇，我們建立了以高速光電互連技術為核心的產品組合。憑藉深厚的技術專業知識與垂直整合式研發平台，我們相信我們處在把握該快速擴張市場中的重大增長潛力的優勢地位。

硅光子技術：高密度、高速及高能效光互連的關鍵

通過將光學與電子元件集成在單個芯片上，硅光子實現了光通信與電信號處理之間的密切協調，將集成電路製造的精度及可擴展性與光子學的高速、低功耗優勢相結合。在硅材料的可製造性及成本優勢的支持下，硅光子實現了高水平的集成度、性能及能效，有效滿足了下一代光電集成技術日益增長的要求。

根據弗若斯特沙利文的資料，按銷售收入計，全球硅光子光模塊市場已由2021年的人民幣207億元增長至2025年的約人民幣631億元，複合年增長率為32.2%，並預期進一步增長至人民幣2,633億元，2026年至2030年複合年增長率為27.1%。

AI驅動的高速光電互連與集成需求

自2022年以來，AI的快速增長使得全球對算力的需求大幅提升。這導致主要科技公司在世界各地建設並改善AI數據中心基礎設施。AI數據中心網絡正在加速向下一代光電集成技術轉變。該等技術逐步應用於產品開發，包括DSP光模塊、LPO、LRO及AEC，以及更先進的NPO及CPO技術。

競爭格局

根據弗若斯特沙利文的資料，光模塊是光通訊體系中實現電光／光電信號轉換的核心產品，是數據中心高速、遠距離互連的關鍵介面。光模塊行業由於持續的技術創新和嚴格的客戶資格要求，進入門檻較高。進一步詳情請參閱本文件「行業概覽」一節。根據弗若斯特沙利文的資料，於往績記錄期間，包括200G、400G以及800G及以上產品在內的各種傳輸速率的光模塊及AOC的價格在行業內普遍呈下降趨勢，主要由於技術日益成熟、產能持續擴張、市場競爭加劇以及大規模生產帶來的成本降低。與此行業趨勢一致，且與我們的行業同業相符，我們每款200G、400G以及800G及以上光模塊及AOC的平均售價於往績記錄期間亦有所下降。我們預期未來800G及以上高速光模塊及AOC價格的跌幅將趨緩，而400G及以下低速光模塊及AOC的價格預計將持續下跌。由於我們策略性地專注於800G及以上高速市場，並計劃擴展通常毛利率較高的海外銷售，我們相信，預期的價格下跌趨勢將不會對我們的財務表現產生重大不利影響。

概 要

歷史財務資料概要

綜合財務資料概要應與本文件附錄一會計師報告的綜合財務資料（包括隨附附註）及本文件「財務資料」所載資料一併閱讀。

綜合損益表概要

下表載列我們於所示期間的綜合損益表主要項目：

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
收入	175,338	100.0	861,832	100.0	1,221,063	100.0
銷售成本	(206,642)	(117.9)	(760,019)	(88.2)	(1,111,307)	(91.0)
(毛損)/毛利	(31,304)	(17.9)	101,813	11.8	109,756	9.0
其他收入及收益	6,389	3.6	3,296	0.4	15,791	1.3
銷售及營銷開支	(7,675)	(4.4)	(10,131)	(1.2)	(15,750)	(1.3)
研發開支	(42,266)	(24.1)	(63,797)	(7.4)	(104,267)	(8.5)
行政開支	(22,492)	(12.8)	(30,850)	(3.6)	(74,134)	(6.1)
金融資產減值撥回/(減值)淨額	5,431	3.1	(1,973)	(0.2)	(2,755)	(0.2)
其他開支及虧損	(13,072)	(7.5)	(7,559)	(0.9)	(9,653)	(0.8)
融資成本	(3,252)	(1.9)	(8,537)	(1.0)	(19,126)	(1.6)
衍生金融工具公允價值虧損	(323)	(0.2)	—	—	—	—
除稅前虧損	(108,564)	(61.9)	(17,738)	(2.1)	(100,138)	(8.2)
所得稅開支	—	—	(157)	(0.0)	—	—
年內虧損	(108,564)	(61.9)	(17,895)	(2.1)	(100,138)	(8.2)
年內其他全面(虧損)收益，扣除稅項	—	—	(321)	(0.0)	114	0.0
年內全面收益總額	(108,564)	(61.9)	(18,216)	(2.1)	(100,024)	(8.2)

有關贖回權會計處理的詳情，請參閱「財務資料 — 股本」及本文件附錄一會計師報告附註29。

我們於往績記錄期間錄得淨虧損，主要由於(i)我們於2023年錄得毛損，原因為我們出售了較高比例的低速產品（包括光模塊及AOC）以降低存貨水平，而我們的高速產品（包括光模塊及AOC）的生產及銷售仍處於爬坡階段，尚未達至最佳生產規模或成本效益。其後，我們的毛利率自2024年起轉正，主要受產量及產能利用率提升所帶來的規模經濟效益及更高製造效率所驅動及(ii)我們於往績記錄期間產生大量研發開支。自2023年起，我們的研發開支佔收入的百分比因

概 要

我們的研發成果實現而顯著下降。我們的研發活動主要集中於下一代高速光互連產品，核心項目包括400G QSFP112光模塊、旗艦級800G全系列模塊，以及面向下一代計算網絡的1.6T前沿光模塊的開發和客戶取樣。上述高速產品已實現商業交付，並形成了獨立的高端高速光模塊收入板塊。該等產品相較於傳統低速模塊具有更高的毛利率，並持續推動我們的整體收入及盈利能力的增長。

收入

於往績記錄期間，我們的收入產生自(i)光模塊，(ii)AOC，及(iii)其他，主要包括光電元件，例如光學次模組(「OSA」)及板載芯片封裝(「COB」)組件，以及原材料，包括印刷電路板組裝(「PCBA」)及其他相關元件。於2023年、2024年及2025年，我們的收入分別為人民幣175.3百萬元、人民幣861.8百萬元及人民幣1,221.1百萬元。

按業務線劃分的收入

下表載列於所示期間我們按業務線劃分的收入明細(按絕對金額及佔總收入的百分比呈列)。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
光模塊.....	123,845	70.6	589,721	68.5	923,944	75.7
AOC.....	46,057	26.3	151,116	17.5	248,127	20.3
其他.....	5,437	3.1	120,995	14.0	48,992	4.0
總計.....	175,338	100.0	861,832	100.0	1,221,063	100.0

於往績記錄期間，我們的光模塊業務線及AOC業務線的增長使得我們的收入取得強勁增長，乃由於(i) AI相關應用推動市場對我們產品的需求快速增長；(ii)我們擴大產能及(iii)我們先進的產品組合。

按地理位置劃分的收入

下表載列於所示期間我們按地理位置劃分的收入明細(按絕對金額及佔總收入的百分比呈列)。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
北美洲						
—美國.....	84,784	48.4	121,207	14.1	93,798	7.7
亞洲						
—中國內地.....	76,124	43.4	623,555	72.4	1,099,262	90.0
—馬來西亞.....	—	—	108,865	12.6	13,690	1.1
—亞洲其他地區.....	11,790	6.7	5,539	0.6	9,705	0.8
歐洲及其他.....	2,640	1.5	2,666	0.3	4,608	0.4
總計.....	175,338	100.0	861,832	100.0	1,221,063	100.0

概 要

於往績記錄期間，我們在中國內地的收入穩步增長，且於2023年至2024年在美國亦實現收入增長。我們的海外市場收入由2024年的人民幣238.3百萬元減少至2025年的人民幣121.8百萬元，主要由於來自馬來西亞的收入減少，因為我們主要客戶的若干項目已於2024年大致完成。

(毛損)／毛利及(毛損)／毛利率

我們於2023年錄得毛損人民幣31.3百萬元，同期毛損率為17.9%，主要由於(i)我們售出大量低速產品；及(ii)我們的高速產品仍處於提升階段，尚未達到最佳生產規模或成本效率。我們於2024年及2025年分別錄得毛利人民幣101.8百萬元及人民幣109.8百萬元，同期毛利率分別為11.8%及9.0%，主要受產量及產能利用率提高帶來的規模經濟及更高的製造效率所推動。詳情請參閱「業務－業務可持續性」。

按業務線劃分的(毛損)／毛利及(毛損)／毛利率

下表載列我們於所示期間按業務線劃分的(毛損)／毛利(按絕對金額及佔收入的百分比呈列)或(毛損)／毛利率明細。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	(毛損)／ 毛利	毛利率	(毛損)／ 毛利	毛利率	(毛損)／ 毛利	毛利率
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
光模塊.....	(31,628)	(25.5)	73,331	12.4	62,308	6.7
AOC.....	303	0.7	27,150	18.0	43,206	17.4
其他.....	21	0.4	1,332	1.1	4,242	8.7
總計.....	(31,304)	(17.9)	101,813	11.8	109,756	9.0

按地理位置劃分的(毛損)／毛利及(毛損)／毛利率

下表載列我們於所示期間按地理位置劃分的(毛損)／毛利及(毛損)／毛利率明細。

	截至12月31日止年度					
	2023年		2024年		2025年	
	(毛損)／ 毛利	毛利率	(毛損)／ 毛利	毛利率	(毛損)／ 毛利	毛利率
	人民幣千元	%	人民幣千元	%	人民幣千元	%
中國內地.....	(23,391)	(30.7)	55,717	8.9	75,612	6.9
海外.....	(7,913)	(8.0)	46,096	19.3	34,144	28.0
總計.....	(31,304)	(17.9)	101,813	11.8	109,756	9.0

有關更多詳情，請參閱「財務資料－經營業績」。

概 要

綜合財務狀況表概要

下表載列我們截至所示日期綜合財務狀況表的選定資料：

	截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
非流動資產總值.....	166,320	234,700	343,058
流動資產總值.....	270,804	777,164	1,486,955
資產總值	437,124	1,011,864	1,830,013
非流動負債總額.....	38,244	117,503	173,765
流動負債總額.....	238,156	682,698	1,070,501
負債總額	276,400	800,201	1,244,266
流動資產淨值.....	32,648	94,466	416,454
資產淨值	160,724	211,663	585,747
股本.....	61,200	62,949	76,111
儲備.....	99,524	148,714	509,636
總權益	160,724	211,663	585,747

有關贖回權會計處理的詳情，請參閱「財務資料 — 股本」及本文件附錄一會計師報告附註29。

我們的流動資產淨值由截至2023年12月31日的人民幣32.6百萬元增加189.3%至截至2024年12月31日的人民幣94.5百萬元，主要是由於(i)貿易應收款項及應收票據增加，及(ii)存貨增加，部分被計息銀行及其他借款增加所抵銷。

我們的流動資產淨值由截至2024年12月31日的人民幣94.5百萬元增加340.9%至截至2025年12月31日的人民幣416.5百萬元，主要是由於(i)現金及現金等價物增加，及(ii)存貨增加，部分被(i)計息銀行借款及(ii)貿易應付款項及應付票據增加所抵銷。

我們的總權益由截至2023年12月31日的人民幣160.7百萬元增加至截至2024年12月31日的人民幣211.7百萬元，主要原因為股東繳付資本人民幣60.0百萬元。我們的總權益由截至2024年12月31日的人民幣211.7百萬元增加至截至2025年12月31日的人民幣585.7百萬元，主要原因為股東繳付資本人民幣460.0百萬元。請參閱本文件附錄一會計師報告所載「綜合權益變動表」。

概 要

綜合現金流量表概要

下表載列我們於所示期間現金流量的選定資料：

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
經營活動所用現金流量淨額.....	(91,042)	(254,808)	(359,097)
投資活動所得／(所用)現金流量淨額....	(98,804)	(106,912)	(111,032)
融資活動所得現金流量淨額.....	71,747	411,366	733,376
現金及現金等價物增加／(減少)淨額....	(118,099)	49,646	263,247
年初現金及現金等價物.....	153,677	32,967	74,963
年末現金及現金等價物.....	32,967	74,963	334,040

於往績記錄期間，我們產生經營活動現金流出淨額，且流出金額於期內有所增加，此主要歸因於營運資金變動，包括存貨增加以及貿易應收款項及應收票據增加，大致與我們於往績記錄期間的業務擴張及銷量增加一致。

有關更多詳情，請參閱「財務資料－流動資金及資本資源－現金流量分析」。

主要財務比率

下表載列我們截至所示日期或於所示期間的主要財務比率：

	截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
流動比率 ⁽¹⁾	1.1	1.1	1.4
速動比率 ⁽²⁾	0.6	0.7	0.8
負債權益比率 ⁽³⁾	99.7%	247.4%	141.4%
槓桿比率 ⁽⁴⁾	1.0	2.5	1.4

	截至12月31日止年度		
	2023年	2024年	2025年
毛利率 ⁽⁵⁾	(17.9)%	11.8%	9.0%

附註：

- (1) 流動比率按流動資產總值除以流動負債總額計算。
- (2) 速動比率按流動資產總值減存貨除以流動負債總額計算。
- (3) 負債權益比率按總負債(即計息銀行及其他借款的賬面餘額)除以總權益再乘以100%計算。
- (4) 槓桿比率等於總負債(即計息銀行及其他借款以及租賃負債)除以總權益。
- (5) 毛利率指毛利佔總收入的百分比。

概 要

更多詳情請參閱「財務資料 — 主要財務比率」。

風險因素

我們認為，我們的營運涉及若干風險與不確定性，其中有些風險與不確定性乃是我們無法控制。我們將該等風險與不確定性歸類為：(i)與我們的業務及行業有關的風險，(ii)與我們經營所在司法權區有關的風險，及(iii)與[編纂]有關的風險。該等風險包括(其中包括)(1)倘採用我們產品的終端市場增長波動，可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響，(2)我們在經營所處行業面臨激烈競爭。倘無法有效競爭，我們的經營業績及財務狀況或會受到重大不利影響，(3)倘我們無法持續優化產品組合以適應技術發展與客戶偏好，且無法及時以具成本效益的方式獲得市場認可，我們的發展前景及經營業績可能會受到重大不利影響，(4)我們的成功在很大程度上取決於我們的研發能力。倘無法推動我們的技術進步、提升我們的研發能力或達成我們預期的研發里程碑，均可能削弱我們的競爭力與盈利能力，及(5)任何產品缺陷或質量不穩定均可能對我們的業務及聲譽造成不利影響。

美國財政部《對外投資規則》的影響

於2024年10月28日，美國財政部(「財政部」)頒佈了關於美國對受關注國家的特定國家安全技術和產品投資的規定(「《對外投資規則》」)，該規則於2025年1月2日生效。

我們的設計活動專注於光通信應用的集成電路，並不涉及《對外投資規則》下半導體及微電子領域「禁止類交易」定義所指的先進半導體製造或設計活動。然而，根據《對外投資規則》，「設計任何集成電路」活動本身即被界定為「受關注活動」，倘由「受關注外國主體」實施則為「申報類交易」。經諮詢法律顧問普衡律師事務所關於《對外投資規則》事宜後，我們的董事認為，我們屬於「受關注外國主體」，且我們從事的活動可能須遵守申報要求。

經諮詢相關法律顧問後，我們認為《對外投資規則》不會對本集團、[編纂]或[編纂]後交易造成重大不利影響，由於(i)儘管美國人士對我們的投資很可能構成《對外投資規則》下的「申報類交易」，但並不構成《對外投資規則》下的「禁止類交易」，因為我們涉及光通信應用集成電路設計的業務不涉及《對外投資規則》下「禁止類交易」定義所指的先進半導體製造或設計活動；(ii)倘美國人士在[編纂]中購買我們的H股被視為申報類交易，則向財政部申報該等申報類交易的義務由進行該等投資的美國人士承擔，而我們在《對外投資規則》下並無申報義務；(iii)非《對外投資規則》所定義的美國人士進行的投資不受《對外投資規則》規限；及(iv)儘管美國人士對我們的投資很可能構成《對外投資規則》下的「申報類交易」，但申報類交易允許美國人士投資於公開交易證券例外，惟須符合《對外投資規則》所規定的若干條件。

概 要

詳情請參閱「風險因素 — 我們面臨與地緣政治相關的風險，包括貿易保護主義及國家安全措施，這可能會對我們的業務、財務狀況及經營業績造成不利影響」及「業務 — 我們對美國的銷售及適用的美國法律法規—《對外投資規則》」。

業務可持續性

我們於2023年、2024年及2025年分別錄得虧損人民幣108.6百萬元、人民幣17.9百萬元及人民幣100.1百萬元，主要由於我們於往績記錄期間正處於由低速產品向高速產品的戰略轉型過程。根據我們的管理賬目，我們過往於2020年及2021年展現出盈利能力，當時我們的業務主要集中於當時市場需求強勁的較成熟100G及以下產品。然而，自2022年起，隨著我們識別到AI數據中心及硅光子技術所帶來的越來越多的機遇，我們已轉向建立以高速光電互連技術為核心的產品組合。該轉型暫時影響了我們於往績記錄期間的盈利能力，經弗若斯特沙利文確認，這與行業趨勢大致相符。

儘管該轉型及爬升的利益於往績記錄期間尚未完全實現，但自2023年研發成果商業化迎來轉折點後，我們已見證強勁的收入增長及規模經濟效應的不斷改善。我們預計通過以下方式進一步改善我們的財務表現並實現盈利：

- (i) 持續的收入增長，方式包括(a)與市場共同增長以把握增長潛力，(b)通過鞏固及擴大我們在海外市場的現有產品供應以實現全球擴張，同時積極推進其他高速產品的市場認證及客戶驗證流程以滿足海外客戶要求，(c)在我們多元化的合作模式下深化與客戶的合作，及(d)持續創造價值並擴大硅光子及光電共封裝產能以滿足客戶需求。
- (ii) 提高成本效益，方式包括(a)進一步利用規模經濟，及(b)通過生產規劃、物料管理及高效生產來提升製造能力，及
- (iii) 提高效率，方式包括(a)將研發成果商業化提高研發效率，(b)提高JDM模式下的銷售效率，及(c)通過數字化內部控制及財務系統優化行政職能。

請參閱「業務 — 業務可持續性」。

法律訴訟及不合規

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無涉及任何我們認為會對我們的業務、經營業績、財務狀況或聲譽及合規情況產生重大不利影響的實際或待決法律、仲裁或行政訴訟(包括任何破產或接管程序)。

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們未曾涉及任何導致罰款、強制行動或其他處罰的重大不合規事件，而該等事件可能個別或共同對我們的業務、經營業績及財務狀況造成重大不利影響。

概 要

單一最大股東集團

截至最後實際可行日期，胡博士、蘇州海怡及蘇州海旭共同於本公司已發行股份總數中擁有21.11%的權益。緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且並無根據[編纂]前購股權計劃發行股份)，彼等將共同於本公司已發行股份總數中擁有[編纂]%的權益，並將繼續為單一最大股東集團。

[編纂]前投資

我們已與[編纂]前投資者完成[編纂]前投資。有關[編纂]前投資者的身份及背景以及[編纂]前投資主要條款的進一步詳情，請參閱「歷史、發展及公司架構—[編纂]前投資」。

股本

我們與各[編纂]前投資者訂立了各自的股東協議，並發行了48,559,313股普通股，總現金所得款項淨額約為人民幣787,139,000元(統稱「[編纂]前投資」)，其中各自的面值部分入賬列為股本，其餘部分入賬列為儲備。根據協議，本公司授予[編纂]前投資者特殊權利，包括贖回權、反攤薄權及清算優先權。

於2025年10月23日，本公司與[編纂]前投資者訂立終止協議，即本公司授予[編纂]前投資者的贖回權已不可收回地終止，並自始無效。在簽署終止協議前，本公司授予[編纂]前投資者的贖回權尚未行使，且若干股東行使的唯一特別權利為提名董事及董事會觀察員的權利以及知情權。經計及本公司司法權區的法律及監管架構以及補充協議的規管法律，我們的董事認為將[編纂]前投資呈列為權益屬適當。

倘本公司授予[編纂]前投資者的特殊權利於訂立補充協議前入賬為按贖回金額公允價值計量的金融負債，則(i)贖回金融負債、流動負債總值、流動(負債)/資產淨值及(負債)淨額/資產淨值如下：

	截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
按公允價值計量且其變動計入損益的			
金融負債	1,175,523	1,224,433	—
流動負債總值	1,413,679	1,907,131	1,070,501
流動(負債)/資產淨值	(1,142,875)	(1,129,967)	416,454
(負債)淨額/資產淨值	<u>(1,014,799)</u>	<u>(1,012,770)</u>	<u>585,747</u>

概 要

及(ii)贖回負債賬面值、年內虧損淨額、每股基本及攤薄虧損的變動如下：

	截至12月31日		
	2023年	2024年	2025年
	人民幣千元	人民幣千元	人民幣千元
按公允價值計量且其變動計入損益的			
金融負債公允價值虧損.....	44,359	48,910	16,257
虧損淨額總值.....	(152,923)	(66,805)	(116,395)
每股虧損			
基本及攤薄(人民幣元)	<u>(2.50)</u>	<u>(1.08)</u>	<u>(1.61)</u>

[編纂]

股息

於往績記錄期間，我們並無派付或宣派任何股息。

我們並無維持正式的股息政策或固定派息率，且我們可能以現金或董事會認為適當的其他方式分派股息。根據組織章程細則，任何擬議分派股息須經董事會裁量及股東批准。本公司董事會可在經計及經營業績、財務狀況、營運需求、資本要求、股東權益及任何其他董事會可能認為相關的條件後，建議未來實施股息分派。我們無法向閣下保證我們將能夠於任何年度派發上述金額或任何金額的股息，甚至根本無法派發股息。宣派及派付股息亦可能受到法律限制以及本公司與我們的子公司已訂立或日後可能訂立的貸款或其他協議的限制。根據適用的中國法律，我們只能以可分配利潤(即除稅後利潤減累計虧損彌補額以及法定資本公積金的必需分配額)派付股息。我們的中國法律顧問告知，由於累計虧損而並無可分配利潤，我們無法向股東派付股息。此外，未來我們可能並無足夠或任何可分配利潤可供我們向股東分派股息，包括我們

概 要

盈利的年度。請參閱「風險因素—與我們的業務及行業有關的風險—無法保證我們是否及何時將宣派及分配任何股息」。此外，我們未來的股息分派能力也取決於我們能否從我們的子公司獲得股息。

未來計劃及[編纂]用途

我們估計，假設[編纂]未獲行使，並假設[編纂]為每股[編纂][編纂]港元(即[編纂]的中位數)，經扣除[編纂]費用及[編纂]以及我們就[編纂]已支付及應支付的估計[編纂]開支後，我們將收取[編纂]淨額[編纂]港元。我們擬將[編纂][編纂]用於以下用途：

- [編纂]淨額的約[編纂]% (或[編纂]港元) 預期用於擴充我們光模塊及其他光電互聯產品的產能，並提升我們各產品線的自動化水平；
- [編纂]淨額的約[編纂]% (或[編纂]港元) 預期用於未來三年內持續投資新產品及技術的研發；
- [編纂]淨額的約[編纂]% (或[編纂]港元) 預期用於未來三年內的業務推廣及市場拓展措施；及
- [編纂]淨額的約[編纂]% (或[編纂]港元) 預期用於營運資金及一般企業用途。

詳情請參閱「未來計劃及[編纂]用途」。

[編纂]開支

我們的[編纂]開支主要包括(i)[編纂]相關開支，如[編纂]費用及[編纂]，及(ii)非[編纂]相關開支，包括就法律顧問及申報會計師提供[編纂]及[編纂]相關服務向其支付的專業費用，以及其他費用及開支。假設悉數支付酌情獎勵費，[編纂]的估計[編纂]開支總額(基於[編纂]的中位數計算及假設[編纂]未獲行使)約為[編纂]港元，約佔我們[編纂]總額的[編纂]%。相關估計[編纂]開支總額中，我們預計將支付[編纂]相關開支[編纂]港元、法律顧問及申報會計師專業費用[編纂]港元以及其他費用及開支[編纂]港元。我們的估計[編纂]開支金額為[編纂]港元，約佔我們[編纂]總額的[編纂]%，已經或預計於損益表支銷，其餘金額[編纂]港元預計將於[編纂]後直接確認為自權益扣減。約[編纂]港元的[編纂]開支已於2025年計入我們的綜合損益表。

概 要

[編纂]前購股權計劃

我們於2025年10月23日採納[編纂]前購股權計劃。有關詳情，請參閱「法定及一般資料」。截至最後實際可行日期，尚未行使購股權項下的相關股份數目為2,800,000股股份，佔緊隨[編纂]完成後已發行股份的約[編纂]%（假設(1)[編纂]未獲行使；及(2)概無根據[編纂]前購股權計劃發行股份）。假設所有尚未行使購股權獲悉數行使，緊隨[編纂]完成後股東的股權（假設(1)所有購股權均獲行使；(2)[編纂]未獲行使；及(3)概無根據[編纂]前購股權計劃進一步發行股份）及我們的每股盈利將被攤薄約[編纂]%。

近期發展及無重大不利變動

於2026年第二季度，我們與一家領先行業合作夥伴訂立戰略合作協議，就面向AI計算基礎設施應用的CPO/NPO解決方案的開發及商業化進行合作。於2026年第一季度，我們與一家主要光連接提供商訂立為期三年的JDM合作協議；此外，我們的高速光模塊榮獲Lightwave創新大獎（全球光通信行業的領先行業獎項），體現對我們技術實力及產品性能的認可。

我們預期於2026年仍會處於虧損及經營現金淨流出狀態，主要由於我們預期持續投資於研發活動，以保持競爭力，把握人工智能技術快速發展所帶來的機遇。有關我們未來財務業績風險的詳情，請參閱「風險因素—我們於往績記錄期間產生淨虧損。無法有效管理我們的增長可能會對我們的業務、未來前景及財務狀況造成不利影響」。

董事已確認，直至本文件日期，自2025年12月31日（即我們的最新經審核財務報表的期末）以來，我們的財務或交易狀況或前景並無重大不利變動，且自2025年12月31日以來，概無發生任何對本文件附錄一所載會計師報告列示的資料產生重大影響的事件。